

第 63 回型技術セミナー

日本でしかできない金型加工技術

—戦略的基盤技術開発—

- ◆ 開催日時：平成16年3月23日（火） 10：00～17：15
- ◆ 開催場所：工学院大学 新宿校舎 11階 第5会議室
- ◆ 主催：型技術協会
- ◆ 趣旨：単純な部品、プラスチックやプレス部品等の量産製品の生産拠点はだんだんアジア各国へ移行してしまうかもしれない。このような状況の中で、これからの日本ものづくり産業が生きてゆくにはどうすればよいのであろうか？難易度の高い日本でしかできない部品（金型）加工、例えばナノテクを駆使した加工やレーザー加工、複雑構造部品成形加工などの技術開発はますます重要になってくる。中小企業事業団の助成「戦略的基盤技術力強化事業」（金型分野）においても、超微細・精密・複雑構造部品成形加工金型技術/金型加工技術は選択する技術区分の一つに位置づけされている。本セミナーでは上記事業に採択されたテーマを含め、日本でしかできないような加工技術にスポットを当て、これからのわが国のものづくりが活性化するための技術的指向についてヒントがえられるよう企画しました。この機会に、講演者との有意義な討論を通して、技術力を深めていただけることを願っています。興味のある皆様には是非奮ってご参加下さい。

◆ 講演者（講演順）

開会挨拶

司会：安齋 正博 氏（(独)理化学研究所）、平井 聖児 氏（ものづくり大学）

- 10：00～11：00 『マイクロ・ナノ成形の展望-成形技術からMEMS応用まで-』
(独)産業技術総合研究所 前田 龍太郎 氏
- 11：00～12：00 『超音波を利用する新しい金型技術
-精密金型加工と精密成形(コイニング)-』
日本工業大学 神 雅彦 氏
- 12：00～13：00 昼 食
- 13：00～14：00 『超精密自由曲面加工機と金型加工事例』
豊田工機(株) 竹内 勝彦 氏
- 14：00～15：00 『マイクロ放電加工』
東京大学生産技術研究所 増沢 隆久 氏
- 15：00～15：15 コーヒーブレイク
- 15：15～16：15 『光硬化型ナノ金型』（仮題）
(株)日立製作所 荻野 雅彦 氏
- 16：15～17：15 『マイクロモールドイング用超小型成形システム』
日精樹脂工業(株) 宮島 正彦 氏

参加費 : 会 員 20,000円 (型技術協会 正・法人会員)
 1,000円 (型技術協会 学生会員)
 一 般 30,000円 いずれもテキスト1冊を含む

◆定 員 : 80名 (申込順で定員になり次第締切ります)

◆申込締切 : 平成16年3月15日 (月)

◆ 申込方法 : 下記の「第63回型技術セミナー申込書」にご記入の上、郵送・FAX 又はEメールでお申込下さい。型技術協会のホームページからはオンライン申込も可能です。お申込の場合は、代金の振込方法を申込書に記入し、振込日をご記入下さい。出来るだけ銀行または郵便振替にてご入金下さい。当日現金払いはできるだけ避けて下さるようお願い致します。

振込銀行 三井住友銀行 三田通支店 普通預金 No. 7813068 型技術協会
 郵便振替 No. 00160 - 1 - 35639 振込手数料は各自でご負担願います。

◆申込先 : 型技術協会 第63回型技術セミナー担当

〒108-0073 東京都港区三田3-4-21 第2 三田朝日ビル3F
 電話 : 03-5419-2707 FAX : 03-5419-2708 Eメール : jsdmt@coral.ocn.ne.jp
 ホームページ <http://www.jsdmt.jp/>

- ◆ご注意 : 1) 参加決定者には参加券をお送り致します。当日参加券と引換でテキストをお渡し致しますのでご持参下さい。
 2) 参加費は開催日以前に入金されるようお願い致します。
 3) 参加費納入後取消の申出が有りますが参加料は返金致しません。ご了承下さい。その場合テキストはお送り致します。

キリトリ

FAX No. 03-5419-2708 型技術協会行

第63回型技術セミナー申込書

「日本でしかできない金型加工技術」-戦略的基盤技術開発-

会社名 :	
住所 : 〒	
電話 : ()	
FAX : ()	
E-mail :	
参加者氏名 (1)	参加者氏名 (2)
所属部署	所属部署
連絡者名 (参加者と同じ場合は記入不要)	会 員 の 有 無 : 会 員 (No .)
所属部署	(○印) 非会員
送金額 : 円也	
入金方法 (○印) : 銀行振込 ・ 郵便振替 ・ 現金	
入金予定日 : 月 日 (銀行振込・郵便振替の場合は原則として領収書を発行しません)	
請求書の必要 : 有	
(○印) 無	